

18.04.2019

Produkt Information

Drucksensor-Systeme – Hinweis zur Verlagerung der Backend-Fertigung von EPCOS Drucksensor-Elementen

Zur Erhöhung der Produktionskapazität der EPCOS Drucksensor-Elemente, die in allen Drucksensor-Systemen verwendet werden, wird die Backend-Fertigung (Vereinzeln, Wafer-Testmessung, optische Inspektion) von EPCOS Drucksensor-Elementen von Stahnsdorf bei Berlin zum Standort Beeskowdamm in Berlin verlagert.

Phase	Geplanter Zeitraum
1. Hochlauf der neuen Produktionsstätte am Beeskowdamm mit dupliziertem Maschinenaufbau für die Backend-Fertigung. Maschinenfähigkeitsuntersuchungen und Prozessfreigabe gemäß TDK Electronics Corporate Guidelines und IATF 16949.	läuft
2. Verlagerung der Ausrüstung von Stahnsdorf an den Standort am Beeskowdamm.	Juni 2019

Damit werden **ab 1. Juli 2019** Drucksensor-Systeme geliefert, die mit Drucksensor-Elementen aus dem Standort Beeskowdamm gefertigt werden.

Diese Änderung hat keine Auswirkungen auf die Lieferzeiten der betroffenen Drucksensorsysteme.

Kontakt Hans Schwang, TPS PRS PM, Berlin

Kunden wenden sich bei Fragen bitte direkt an ihren Ansprechpartner im Vertrieb.

TDK Electronics AG

Rosenheimer Straße 141 e, 81671 München · Post: PF 80 17 09, 81617 München, Deutschland
Sitz der Gesellschaft: München · Registergericht: Amtsgericht München HRB 127250
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Werner Faber
Vorstand: Joachim Zichlarz, Vorsitzender · Joachim Thiele · Dr. Werner Lohwasser
www.tdk-electronics.tdk.com

**Thermistoren,
Sensoren**
Intern / Extern

190418THERM1g